



JESSICA

SEMINAIRE

20 et 21 septembre 2004

FAIRE FACE A L'INTERDICTION DU PLOMB DANS L'ELECTRONIQUE

PROGRAMME

Lundi 20 Septembre 2004

8h30 – 9h00 **Présentation, Introduction (JESSICA France, DRIRE Alsace)**

9h00 – 10h00 → **Le Sans plomb, coté réglementation : (Snese, Euro Info Centre de Strasbourg)**

- Le sans plomb, un enjeu économique pour le futur (situation, concurrence...)
- Les directives ROHS et WEEE et leurs implications concrètes.
- Quels sont les produits concernés ?
- Respect de la ROHS sur le marché Européen, qui en est responsable ?

10h15 – 12h00 → **L'achat des composants (Sony, Snese)**

- La situation actuelle du marché mondial, des distributeurs Français (Snese)
- Les démarches pour garantir l'achat de composants sans plomb (Sony)

12h00- 13h00 Repas en commun

13h00 – 15h00 → **Le brasage Sans Plomb, théorie (Iftec)**

- Les procédés actuels et les principaux problèmes rencontrés
- L'alliage SnPb et ses principales caractéristiques (Mouillabilité constitution de l'alliage, caractéristiques du joint de soudures, composés intermétalliques les flux, forme de la brasure, températures)
- Les nouveaux alliages sans plomb et leur caractéristique (binaires tertiaires quaternaires, (Mouillabilité constitution de l'alliage, caractéristiques du joint de soudures, composés intermétalliques les flux, forme de la brasure, températures)

15h15 – 17h00 → **Les impacts sur la production (Iftec)**

- Impact sur les composants (déformation, humidité, résistance à la chaleur, chocs thermiques...),
- Impact sur le circuit imprimé (types de laminés, caractéristiques (Tg, dilatation, résistance à la

chaleur, tenue des pastilles, halogen free), finitions, le design des cartes...),

17h00 – 18h00 → **Visite Site de production « Sony »**

18h00 – 19h00 → **Exposition, présentation des fournisseurs de composants**

19h00 – 21h00 Repas en commun

Mardi 21 Septembre 2004

9h00 – 12h00 → **Les impacts sur la production (Iftec)**

- Impact sur les produits organiques (flux, crèmes, vernis, nettoyage...)
- Impact sur le procédé de refusion (les températures de four et compatibilité, fenêtres thermiques...)
- Impact sur le procédé vague (principe de fonctionnement, profil type, compatibilité...)

12h00- 13h00 Repas en commun

13h00 - 14h00 → **Les impacts sur la production (Iftec)**

- Impact sur le brasage manuel,
- La compatibilité des procédés avec et sans plomb (Production, SAV...)

14h00 – 15h00 → **Les impacts de l'augmentation de l'étain dans l'alliage (Iftec)**

- Impact sur l'oxydation (Scorie...)
- Impact sur la dissolution (pollution)
- Impact sur le produit dans le marché (Wiskers..)

15h15 – 17h00 → **Les impacts sur les contrôles, fiabilité (Iftec)**

- Le procédé Vision
- Le contrôle interne (Rayon X...)
- Les protocoles de validation le joint, la carte électronique, fiabilité égale ou supérieur ?
- Contamination

organisé par JESSICA France, dans le cadre d'une opération collective sous financement DRIRE Alsace, en partenariat avec le SNESE, SONY et l'EURO INFO CENTRE de Strasbourg.